

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	OMNIMATE Data - gniazdo USB, Gniazda USB, 480 Mbps, Przyłącze lutowane SMD, 180°, ≥ 10000, Raster w mm (P): 0.65 mm, Liczba biegunów: 5, LCP, czarny, Tape
Nr zam.	2762070000
Typ	USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK
GTIN (EAN)	4064675035299
Ilość	2 000 Szt.
opakowanie	Tape

Data sporządzenia 7 czerwca 2024 01:43:24 CEST

Aktualizacja katalogu 01.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	2,9 mm	Głębokość (cale)	0,114 inch
Wysokość	10,51 mm	Wysokość (cale)	0,414 inch
Szerokość	7,99 mm	Szerokość (cale)	0,315 inch
Masa netto	0,299 g		

Właściwości elektryczne

Prąd znamionowy	1 A	Rezystancja skrośna	<25 mΩ
Wytrzymałość izolacji	≥ 100 MΩ	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	100 V AC
napięcie znamionowe	48 V		

Specyfikacje systemu

Cykle wpinania	≥ 10000	Długość kołka lutowniczego (l)	0 mm
Ekranowanie	Tak	Klasa mocy	480 Mbps
LED	Nie	Liczba biegunów	5
Materiał ekranu	Stal nierdzewna	Powierzchnia ekranu	niklowany
Proces lutowania	Lutowanie rozplływowe, Lutowanie ręczne	Raster w calach (P)	0,026 "
Raster w mm (P)	0,65 mm	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Rodzina produktów	OMNIMATE Data - gniazdo USB	Siła ciągnięcia / biegun, min.	10 N
Siła wtykania/biegun, maks.	35 N	Stopień ochrony	IP20
Szybkość przesyłania danych	480 Mbps	Tolerancja pozycjonowania kołka lutowniczego	± 0,1 mm
Wymiary kołka lutowniczego	ośmiokątny	kąt odejścia	180°
montaż na płytce drukowanej	Przyłącze lutowane SMD		

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	LCP	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	Wytrzymałość izolacji	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
podstawowy materiał styku	stop miedzi	Materiał styków	Stop Cu
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Struktura warstwowa wtyku	≤ 1 μ" Au
Temperatura magazynowania, min.	-40 °C	Temperatura magazynowania, max.	70 °C
Temperatura pracy, min.	-30 °C	Temperatura pracy, max.	80 °C

Opakowanie

opakowanie	Tape	Długość VPE	462 mm
Szerokość VPE	450 mm	Wysokość VPE	166 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Powiadomienie o zmianie produktu

[Änderung der Verpackung – 2762070000 USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK](#)

[Change of packaging – 2762070000 USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki



Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.